

SWCC株式会社

スモールミーティング 質疑応答

実施日時：2026年6月12日（金）

実施場所：東京都中央区日本橋兜町



[Q]：貴社はファイバを外部調達されているかと存じますが、調達に問題は生じていないでしょうか。また、課題事業と位置づけている事業について、収益性改善は来年以降がメインとなり、今期中は前期並みの推移となる見込みでしょうか。

[A]：それでは、お答えします。

まず1点目、ファイバの調達についてですが、世界的に光ファイバが不足していることは周知のとおりです。しかし、当社では複数のサプライチェーンを確保し、さまざまなファイバーメーカーから調達できる体制を整えておりますので、現時点で調達に大きな問題は生じておりません。

次に、課題事業の収益性改善についてご質問いただきました。こちらについては、現在、さまざまな施策を講じている段階ですが、今期中の収益性については前期並みで推移する見込みです。収益性の大きな改善については来期以降になると考えております。

課題事業と位置づけております巻線事業ですが、宮城県の山元工場を今年中に閉鎖することを決定し、現在その準備を進めております。また、一般汎用巻線事業については、価格交渉などにより採算改善を図っています。

さらに、ワイヤハーネス事業も課題事業と認識しており、中国やベトナムの生産拠点の統合・再編に着手しています。加えて、中国のローカル家電メーカーなどへの対応も強化し、採算改善に取り組んでいます。これらの施策の成果が本格的に現れるのは来期以降になる見通しです。

[Q]：コンタクトプローブピンの売上規模、収益性のイメージをお教えてください。

[A]：ご質問いただき、ありがとうございます。コンタクトプローブについてですが、売上規模は年間でおおよそ40億円程度とご理解ください。収益性については、製品がより細く高精度になるほど収益性が上がる傾向があります。特に、TOTOKUのみで生産できる15ミクロンといわれる極細製品の増産を進めており、このような高付加価値品の拡大によって、さらなる収益性向上を図ってまいります。

[Q]：質問2点お願いします。電力と半導体を1つずつです。

1つ目、電力はさまざまな拡販施策をお示しいただいたのですが、収益性、利益率の向上余地についてご解説いただければと思います。これまでSICONEX、SICOPLUSを中心とする数量拡大は非常に利益率もおそらく高いということで、かなりいいところまで利益率が上がってきている印象で

す。さらに e-Cable や Y 分岐接続部の上市、拡販でさらなる利益率向上が、SICONEX のお話が出ている頃だともうそろそろ結構いいところまできているというお話でしたが、さらに収益性で上を目指せるのか、その手応えを教えてください。

[A]：収益性の面では、当社の強みである SICONEX が大きく寄与しています。SICONEX は、他社には真似できない軽量化や小型化を実現しており、この点が収益性の向上につながっています。さらに、現在力を入れているのは、資料の一番下にも記載した「施工人材の高圧分野へのシフト」です。従来は 66kV や 77kV を中心に展開してきましたが、今後はさらに高い電圧帯である 154kV や 275kV への展開を進めていきます。ここでも SICONEX 技術を活かすことで、利益率の向上が期待できます。また、施工人材も高圧分野へシフトすることで、より高収益な事業構造へ移行していく方針です。以上より、今後はさらに一段、二段と収益性の向上が期待できると考えています。

[Q]：やはり SICONEX の中での構成改善がそのキーになるのですかね。e-Cable の拡充や Y 分岐接続部は数量拡大、売上拡大に寄与するとは思いますが、利益率改善の努力しろとなると SICONEX になるのですかね。

[A]：Y 分岐接続部もベースは SICONEX 技術なのです。ですから、別の括りに置いています、これも SICONEX と考えていただいても結構です。

[Q]：半導体について、コンタクトプローブ、RUOTA、TIW とお示しいただきました。増産のお話があり、現状のそれぞれの製品のキャパシティはおそらく結構カツカツな気がするのですが、RUOTA は前年度比 4 倍の増産計画ですが、他のところも 1.5 倍だとか、この伸びを見ていると、またすぐに足りなくなってしまう気がします。

そこは大丈夫なのか。今後さらに増やすとすると、建屋を増やしたりする必要はない範囲で、比較的リードタイムを、製造ラインを増やせばいいという範囲で、わりとリードタイム短くそこは対応可能なか確認させてください。

[A]：ご質問ありがとうございます。お答えいたします。ご指摘の通り、現在、注文が急増しており、当初計画していた投資だけでは対応が難しくなっています。そのため、建屋の制約を踏まえつつ、建屋を有効活用しながら設備を導入していく方針です。主な設備投資の拠点は TOTOKU の上田工場になります。加えて、当社は中国の浙江省に「TOTOKU 浙江」という現地法人を有しており、「ミニ上田」とも呼ばれています。上田工場で可能な生産は、ほぼ浙江の工場でも対応可能です。このように国内外の拠点を有効に活用し、いただいている需要にしっかりと対応できるよう、適切に設備投資を進め、リードタイムの短縮に努めてまいります。

[Q]：固定費の増も想定されますが、今後の、これだけ需要が拡大しているところだと、それをしっかり吸収できるだけの価格交渉も可能な体制なのですか。それとも、長期契約であまり価格交渉は容易でない領域なのか、最後にそれだけ確認させてください。

[A]：そうですね。3つの主要製品それぞれに特徴がありますが、まず RUOTA と呼ばれる製品については、お客様から増産のご要望を強くいただいております、ここへの投資分は十分に価格面で回収で

きる見込みです。コンタクトプローブについては、先ほども申し上げた通り、業界では 40 ミクロン以下のものを「細物」、70 ミクロン以上を「太物」と呼んでいます。この 2 つでは価格差が 2～3 倍あり、細くなればなるほど付加価値が高く、収益性も上がります。太物の生産を手掛ける会社は他にもありますが、40 ミクロンの細物を量産できるのは、TOTOKU を含めて 1～2 社ほどしかありません。そのため、今後はこの細物への設備投資を強化し、生産量の拡大を通じて収益性向上を目指したいと考えています。

[Q]：コンタクトプローブについていくつか質問させてください。以前、コンタクトプローブの今後の成長の市場として 4 端子法の採用などが追い風になると書いてありましたが、現状御社の技術力が優位になる市場について、4 端子法の採用や進捗について教えていただければと思います。

[A]：ご指摘の通り、コンタクトプローブの市場では、4 端子と呼ばれるより微細化されたチップの需要が拡大しています。これに対応するため、30 ミクロン以下の細物プローブの需要が大幅に増加する見込みです。また、4 端子化によって必要となるプローブの数が 2 倍になる点も大きな特徴です。当社としても、この分野に特に注力しており、細物を中心とした設備増強を進めることで、こうした市場の需要拡大にしっかり対応していきたいと考えています。

[Q]：4 端子の市場は順調に拡大しているという理解で大丈夫でしょうか。

[A]：そうですね。ご承知の通り、直近では Google の TPU (Tensor Processing Unit) の生産が開始されたという記事が日経新聞にも掲載されていました。TPU のような最先端の AI 半導体は非常に微細なチップで構成されているため、今後も 4 端子プローブの需要はさらに拡大していくと考えています。

[Q]：また、前工程の拡大について、前工程における競合状況やサンプル、今年から販売開始ということですが、手応え、御社はどれくらいシェアを拡大できそうなのかという見通しも含めて教えていただきたいと思います。

[A]：COBRA と呼ばれる製品については、すでに多くのご注文をいただいております。「もっと早く大量に生産してほしい」というご要望が高まっています。現状、作ればすぐに売れる状況ですので、量産技術の確立と生産設備の増強を精力的に進めており、現在は COBRA の増産が中心となっています。また、カンチレバータイプや MEMS タイプについても、新たな検査装置の分野でニーズが出てきており、ここでは SWCC が持つ材料技術が不可欠です。こうした分野でのシナジーを活かしながら、何とか今年度中には量産体制を確立したいと考えています。カンチレバータイプについても、すでにある程度形になってきているため、今後さらにサンプルの製作とお客様への供給体制を強化していく方針です。

[Q]：最後に 1 点、三層絶縁電線について現状の売上規模、TOTOKU の売上の何割とかでもいいのですが、数字があれば教えていただけないでしょうか。

[A]：そうですね。TIW は、中にエナメル線（焼付線）をより合わせ、その上にテープを 3 層巻いて絶縁するという特徴を持った製品です。現在の売上規模は年間で約 20 億～30 億円程度とお考えいただければと思います。また、先ほど申し上げた通り、現在はこの売上が約 4 割増加している状況です。

[Q]：このワイヤープローブの、お客様の具体的なイメージをつかみたいと思います。今、後工程向けが中心ということなので、多分ウエハーレベルテストのプロブカードメーカーが主要なお客様というよりは、別のお客様なのかなというイメージを持っています。

何かヒントになる情報ということで、具体的には半導体治具メーカーは何を作っているメーカーと考えたらいいですかね。

[A]：ご質問ありがとうございます。申し訳ありませんが、お客様の社名は公表できません。ただ、ご指摘の通り、検査装置用治具を製造するメーカーが主要なお客様のひとつです。また、コンタクトプローブは消耗品のため、一定期間使用すると交換が必要になります。治具メーカーが交換用ピンを購入する場合もあれば、テスターメーカー自身が直接購入する場合があります。そういったイメージでご理解いただければと思います。

[Q]：足元のけん引役となっているアプリケーションは、もうあまりロジックもメモリも特に色なく、両方とも大きくけん引しているという理解でいいのですか。

[A]：そうですね。従来はロジック系が中心でしたが、最近ではメモリ分野でも需要が増加しており、現在は両分野とも伸びています。それに伴って、検査用のピンの需要も増加している状況です。そのようなご理解で問題ありません。

[Q]：メモリが大きく伸びてきているのは、プローブカードメーカーの状況などを見ていると、かなり HBM が引っ張っていると理解しているのですが、この TOTOKU のワイヤープローブも、HBM がかなりメモリはけん引しているという理解でよろしいですかね。

[A]：そうですね。HBM については、先ほど申し上げた 40 ミクロンや 30 ミクロン以下の細物への引き合いが非常に増えてきており、これが HBM 用途としての需要拡大を反映しているものと考えています。

[Q]：そこはかなりけん引役になっているということですね。最後に、先ほどの端子数が増えることがこのワイヤープローブの大きなドライバーになっているというお話でしたが、そもそもこの端子数が増えている背景としては、この半導体の微細化になるのですかね、ドライバーとしては。

[A]：はい、ご理解の通り、微細化と大容量化が同時に進んでいる状況です。大量のデータを高速で演算処理する必要があるため、半導体はより大規模になっていますが、その中で微細化も求められています。その手段の一つとして、当社では 4 端子化が挙げられると捉えています。

[Q]：端子数を増やせば容量を増やせるということですね。

[A]：はい、そのような理解で間違いありません。

[Q]：2 つあります。1 つ目は確認です。今日ご解説いただいた鉄鋼など、そうした話は今まであまりうかがっていなかったのでびっくりしているのですが、こうした鉄鋼関連の伸びは中計などにちゃんと織り込まれているか確認させてください。

[A]：中期経営計画には当然、この分野も織り込んでおり、数値目標も設定しています。ただ、私たちが把握している以上に、現在多くの引き合いが来ている状況です。とはいえ、実際の案件が動き出すのは来年または再来年以降になる見込みで、今は各社で具体的な計画が進められている段階です。なお、2030 年までの数値も中計に反映していますが、先ほど申し上げた通り、実際にはこれを上回る可能性もあると考えています。

[Q]：もう 1 つよろしく申し上げます。今日の説明会であまりなかった e-Ribbon の質問で恐縮ではあるのですが、電線メーカーさんが今ケーブル不足の中で、御社はどうその状態を見ているのかを教えてください。

例えば、ビジネスチャンスがある、もしくはない、大手電線メーカーのケーブル不足の中で御社がうまく立ち回るとよりアップサイドを狙えるなど、何かそうした事例があれば教えてください。

[A]：当社のビジネスモデルについては、以前からご説明している通り、主な柱は e-Ribbon の販売です。具体的には、まずファイバを調達し、当社独自の技術でリボン化したものをお客様に提供し、お客様自身でケーブル化していただくビジネスモデルがあります。もう一つは、当社がケーブルとして完成品まで製造し、お客様に納めるというモデルです。いずれも展開しておりますが、事業の中心は e-Ribbon の販売となっています。

[Q]：例えばクラウド事業者などがいろいろいる中で、大手電線メーカーさんはもうフルフルですと、そのときに「SWCC さんにちょっとお願いしますね。」みたいな量が今までより増えている、増えていない、その辺はいかがですか。

[A]：われわれもまさに設備投資を行っているところで、かなりいろいろなお客様から要求がきています。それに応えられる中で投資も計画し、実行中です。

[Q]：先ほど出た e-Ribbon は、今期売上高目標と今後、中計で出していただいた 2025 年比 7 倍の増産などを考えたら、中計目標の数値は既に低いというか、上振れ余地あると思うのですが、こちらについての考え方、現在の状況も含めて教えていただけますか。

[A]：ありがとうございます。中期経営計画の説明会でもお伝えしましたが、e-Ribbon の売上については、2026 年までで CAGR（年平均成長率）38%の伸びを見込んでいます。売上規模としては、全体 350 億円のうち、およそ 7 割が e-Ribbon によるものになる見込みです。そのようなイメージでご理解いただければと思います。

[Q]：それでは、現状の進捗が特にその計画を上回るペースという理解で大丈夫ですか。

[A]：結構です。現在ご説明した以上の売上も見込んでおり、2026年度から2030年までに30億円の投資を計画しています。それに向けて準備を進めているところです。

[Q]：ご説明ありがとうございました。三問ありますので、一問ずつよろしくお願います。

まず一問目は、電力インフラ事業についてです。今日ご説明いただいた、かねてからお話のある電力会社向けのビジネスと民間の需要、またデータセンター関連というくくりで見たときに、足元の構成比、収益貢献がどういった状況で、これが2030年に向けてそれぞれどういった構成比になっていくというのを全体感として、電力インフラ事業として見ているのか。

また、それぞれ足元も収益性は非常に電力インフラの事業は高いとは思いますが、2030年を見据えたときに収益性の改善をさらに押し上げていく意味で、一番御社が期待しているエリアはどこになるのか教えていただけますか。

[A]：当社の強みは民間向けの事業です。電力会社向けの大規模な系統分野については、当社の実力では難しい面もあり、従来より変電分野に力を入れてきました。変電所へとつなぐケーブルや、SICONEXなどの接続部に注力する姿勢は、今後も変わりません。

一方で、今回説明したように、データセンター市場は非常に大きいと考えています。データセンターの建設に伴い、新しい変電所や接続部の需要が発生するため、ここでも大きなビジネスチャンスがあると見込んでいます。

電力会社向けに加え、今後はさらに民間分野の拡大を目指しています。また、鉄鋼メーカー向けも非常に大きな市場であり、調査の結果、大きな需要があることが分かってきました。すでにお客様からも多くの引き合いをいただいています。

実際の受注や本格的なプロジェクトの開始は2027年以降となる見通しです。そこで、154kVのY分岐やe-Cableといった当社の強みとなる製品を活用し、施工人材を確保しながら事業を進めていく方針です。この方向性はこれまでと大きくは変わっていません。

[Q]：二問目は、もう一つ電力インフラについてです。2月に中計を出していただいたときには、少し海外展開を見据えてお話しされていたと思います。

今日ご説明いただいた、こういったデータセンター関連の製品など、何か御社の中で海外展開していく中で特に優先順位が高い、あるいは注目しているエリアはありますか。

[A]：まだ調査段階ではありますが、当社としてはアジア圏での展開を視野に入れていますが。ただし、戦略として「フルターンキー」でケーブルや端末を販売し、工事まで請け負うようなビジネスモデルは考えていません。これまで培ってきたSICONEX技術を、海外メーカーにどのように展開していくかを現在模索しているところです。近いうちに、より具体的な戦略についても皆様にお伝えできればと考えています。

[Q]：三問目が、通信コンポーネントの TIW について、昨年の夏頃のご説明ですと、AI サーバー以外の用途もそれなりにあり、市場の伸びという、AI サーバーの伸びに対してはこの製品の伸びはそんなに大きくないとご説明いただいた記憶があります。

足元、この 1 年ぐらいで市場の活況を受けて構成比が AI サーバー用途はかなり上がってきているのか、またこの 2030 年ぐらいを見据えたときの CAGR も以前から何か変化が出ているのか教えていただけますか。

[A]：ご質問ありがとうございます。ご指摘の通り、昨年秋以降、AI サーバー需要が急速に拡大しており、当社の主要なお客様もこの分野に強みを持っているため、TIW の需要が想定以上に急増しています。もともと TIW は AI サーバー以外の用途にも使われていましたが、現在は AI サーバー向けの需要が大きな割合を占めていると感じています。その根拠として、TIW には大きく分けて単線タイプとより線タイプ（計 4 種類）がありますが、特により線タイプの注文が大幅に増えている状況です。このより線タイプが、AI サーバー用途で必要となる大容量電源用として使われているのではないかと考えており、今後の伸びに非常に注目しています。また、現在は需要に生産が追いつかない状況となっており、増産体制の強化に取り組んでいます。近く主力のお客様ともミーティングを行い、来年度以降もこの需要が続く場合には、パートナーシップ契約や投資についても具体的に協議していきたいと考えています。

[Q]：二つお願いします。一点目が、電力インフラです。かなり需要が増えてきそうだというの理解できたのですが、これを施工する人員の確保という点を確認させていただきたいです。

御社の SICOPUS で協力会社さんも増やしていくので、ここは御社のキャパシティとして事業拡大に問題はないのか。また、お客さんサイドでもその建設の人員を確保できるのかの制約になってくるリスクもあるとは思いますが、その辺りも含めて現状どう見ているのか教えていただけますか。

[A]：おっしゃる通り、建設現場の環境は厳しくなっており、また、当社だけの人材で全ての施工を賄うのは限界に近づいています。そのため、いかに協力会社を活用するかが重要と考えています。協力会社には比較的簡易な工事を担当してもらい、当社は高度なスキルが必要な超高压領域を中心に担う方針です。すでに複数の協力会社と契約も締結しています。

また、大手工事会社ともパートナーシップを構築し、フレキシブルに工事対応できる体制を作り上げてきました。そのため、様々な形で施工人材を確保できており、施工能力については十分に対応可能だと考えています。

[Q]：二点目が、資料 16 ページ目を拝見しながらです。通信コンポーネントの中で、中計では半導体の分野については M&A なども含め成長強化していくと、産業用とモビリティについてはハードルも設定し 2 年以内に状況を見極めるという方向性を打ち出されていると思います。

その辺りの現状の具体的なアイデアや何か補足説明できることがあれば教えていただけないでしょうか。

[A]：ご質問ありがとうございます。このページは TOTOKU にフォーカスした内容となっており、ご質問いただいたモビリティ分野および産業用分野については、TOTOKU を中心に今後 2 年間で収益性を見極めていく計画です。先ほど山村よりご説明した通り、TOTOKU グループ内では構造改革を進めており、人材の最適配置や成長分野である半導体へのシフトを図っています。TOTOKU 自体でも構造改革を着実に進めており、その成果として、今年度から来年度にかけて営業利益で15 億円規模の改善を目指しています。グループ全体としても、モビリティや産業用分野への様々な取り組みを行っています。

モビリティ分野では、これまで注力してきた駆動用モーターが xEV 市場の環境変動により厳しい状況となっており、現状は耐える時期が続いています。しかし、需要の規模に見合った製造体制への見直しや、高付加価値製品の拡充を進めることで、今期中にも一定の効果が現れるよう取り組んでいます。

産業用分野については、汎用巻線が日本市場を中心に需要低迷が続いています。対応策として、昨年、宮城県山元工場の閉鎖を決定し、今年の早い段階で生産を停止したため、その一部効果が今期に表れてくる見込みです。

また、中国のワイヤハーネス事業については、激しい価格競争の中で、当社の強みが発揮できる分野に集中しつつ、生産拠点の再編を進めています。この効果は 1 年かけて積み上がる見込みで、来期以降に表れる予定です。中国市場は依然厳しい環境にありますが、当社は家電向け製品に強みがあるため、日系のみならず中国現地家電メーカーにもチャレンジし、収益改善に取り組んでいます。今後 1 年かけてこうした改革の効果を最大化し、収益性を見極めていきますが、期待した効果が得られない場合は、さらなる見直しも検討していきます。

[Q]：私からも二点お願いできればと思います。一つ目は、13 ページと 14 ページで示していただいている鉄鋼の CV ケーブルの張替と電炉化のところですか。

この辺り、御社の国内シェアはどれくらい取れそうなのか教えていただきたいです。あらためて、もし高いシェアが取れそうなのであれば、その背景もあわせて教えていただければと思います。

[A]：ありがとうございます。正確なシェアを申し上げるのは難しいですが、全体の 3 割程度は獲得したいと考えています。当社の強みは、先ほどご説明した SICONEX 技術を活かした製品開発にあります。また、鉄鋼メーカー様が抱える設計技術・施工人員の不足という課題に対して、当社は設計から製造・施工・保守までを一括対応できるソリューションを提供することができますので、鉄鋼メーカー様にとっても大きなメリットとなります。こうした強みを武器に、今後も着実にシェア獲得を目指して体制を整えていきたいと考えています。

[Q]：生産キャパシティなどは特に問題ないのでしょうか。

[A]：すでに投資を進めており、今年も引き続き対応しています。これらの投資が完了すれば、生産キャパシティには全く問題ないと考えています。

[Q]：二点目は、今大変分かりやすくご説明いただいて、その電力インフラもそうですし、半導体やプローブ、RUOTA などいろいろ出てきましたが、全般的に需要が足元で強い状況が、おそらく数カ月前よりも見えてきているのかなという印象を受けました。

中計は2月に発表されていたので、ここからもさらに上積みできそうなのか教えていただきたいと思います。どの辺りの事業で需要を含んでいて、その辺りが中計に入っていないなど、この辺りご解説いただけないでしょうか。

[A]：成長事業として位置付けている電力インフラについては、先ほどご説明したデータセンターに加え、民間の鉄鋼分野も今までは把握しきれていませんでしたが、ここ数カ月で全体像が明確になり、引き合いも強まっています。ここが一つの大きなポイントです。

また、本日は詳しく説明していませんが、海外通信分野においても、e-Ribbon を武器に光ファイバ需要の拡大に対応しています。今後、この分野での当社の参入がさらに加速し、投資も順調に進んでいることから、中期経営計画を上回る実績が期待できると考えています。

さらに、半導体分野についても、昨年度の第4四半期あたりから大きな伸びが見られており、当社の想定以上の成長が期待できる状況です。

これらの成長事業は、中計で計画した以上の成果が見込めると考えています。

[Q]：ちなみに、中計の数字は何か大体どれくらいのタイミングで作られたとかありますか。去年時点とか。

[A]：はい。2月です。

[Q]：2月の数字なので、数字を固めたのが例えば年末ぐらいだったとか。

[A]：年度末ぐらいには固めていきます。

[Q]：Y字分岐のご説明で、66kVのところは電力会社向けを中心に90%近くのシェアを持っているというのが、非常に高い競争力を持っていると思います。

もともとこの事業の滑り出しと言いますか、出だしを考えたときに、何をもって御社がこの市場で高いシェアを取れたのか。電力会社向けさんからの需要はどういったところで、御社としていつ頃からこのY字分岐が事業として立ち上がっているのか、この少し経緯を教えてくださいませんか。

[A]：ありがとうございます。Y分岐の導入は10年以上前から電力会社向けに始まっています。従来、変電所から需要家までを1本のケーブルで直線的につなぐ場合、非常にコストがかかりますが、既存のシステムの途中で分岐を設けることで、ケーブルの使用量を約半分に削減できるため、コスト面で大きなメリットがあります。この点に着目し、当社はY分岐製品の提供を進めてきました。当社製品の強みは、他社製品に比べて非常にコンパクトでスキルレス、工期も短縮できるという点です。実際に多くのお客様に長年ご愛用いただいており、高いシェアを維持しています。

[Q]：ここから補足で 154 kV、例えばデータセンターの大容量化の事業は、28 年に製品を立ち上げてと、見通しは出していただいています、28 年度からここが伸びてくると見ているのか、ある程度市場が立ち上がってくるのは 30 年ぐらいで、そこに向けて 28 年ぐらいから準備されていくと見ているのか、いかがでしょうか。

[A]：おおよそ 2027～28 年頃から徐々に立ち上がり、2030 年度後半には大きく伸びていくというのが一般的な見通しです。スライドには「2028 年上市」と記載していますが、できるだけ前倒ししたいと考えています。ただし、電力会社向けやデータセンター向けの電源供給機器は非常に高い信頼性が求められるため、長期間の負荷試験や信頼性試験が必要です。そこは決しておろそかにせず、十分な検証を経て、確かな製品を提供していく方針です。

[Q]：電力会社向けの需要は、一部に更新需要などのところもあるのですが、ある程度価格も、値段が上がっちゃっているところもあり、だいぶ予算を先に使っているような話を聞いたりします。この辺りで何かその需要の減速などを気にする必要があるのか、あるいは変えなければならないところを変えなければならないので、価格のところでは上がった分は例えばその予算を電力会社さんのほうが増やす方向にあるのか、もしこの辺りで何か御社で見えている姿があれば教えてください。

[A]：現在、国内インフラの維持が大きな課題であることは国も認識しており、老朽化設備の更新についても、数年前の OF ケーブル破損事故以降、国の方針として積極的に進められています。こうした中、材料費や人件費の上昇分についてもお客様にご理解いただいております。当社としても適正な価格で供給する方針を徹底しています。この考え方はお客様とも十分に共有できており、健全な関係のもとで事業運営を行っています。

[Q]：データセンター向けの、先ほど Y 分岐で品質が大事とおっしゃってました。この御社が言う HSBC は、米国のハイパースケーラーさんがアメリカや日本で作っているようなデータセンターを示しているのか、それとも国内系のさくらインターネットさんあるいはソフトバンクさんなどが使えるようなデータセンターを言っているのか教えてください。

というのは、米系のハイパースケーラーが日本に来る場合は、彼らなりの既に品質レベルがある気がして、その認証を取らなくてはならないなどがあるのか、その辺りが気になりました。

[A]：当社は国内のハイパースケール向けに、国内仕様で供給しています。

[Q]：何か追加的に認証が必要とかそういうわけではないということですか。

[A]：ありません。

司会 [M]：ありがとうございます。最後に、小又社長から一言いただいて終了としたいと思います。

小又 [A]：本日も、活発にご質問いただきましてありがとうございます。

今日ご紹介した電力インフラ、また TOTOKU の半導体のご理解を深めていただけたと思う中で、私が冒頭申し上げた今期の営業利益 285 億円は慎重にということのご理解をいただけたかなと思います。

当初見ていた中東のサプライチェーンの混乱も緩和してきたということは、正常化までは少しかかるとは思いますが、緩和してきて、活発な旺盛な市場の受注を、特に電力インフラで受注を取っていけるところが見えてきたところではあります。

データセンター、半導体、AIという市場に対して、われわれのこの成長事業、今日ご紹介できなかったですが、e-Ribbon も含めてこの三つですね、こちらでこの 285 億円という営業利益をボトムにして、どこまで積み上げていけるかという 1 年にしたいと思っています。

しっかりと増収増益し、中期経営計画のスタートの年を切っていきたいと思っていますので、ご期待いただければと思います。よろしくお願いいたします。